



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	提取芯片版图的版图图形特征的方法及CMP仿真方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201310573229.X
申请日期:	2013-11-13
专利号:	ZL201310573229.X
第一发明人:	刘宏伟;陈岚;孙艳;张贺;方晶晶
实施情况:	授权
专利证书号:	ZL201310573229.X
其它备注:	EDA中心

